


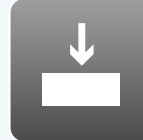

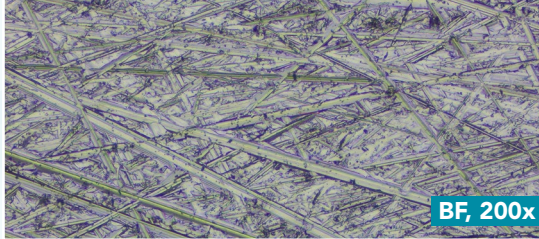



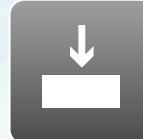

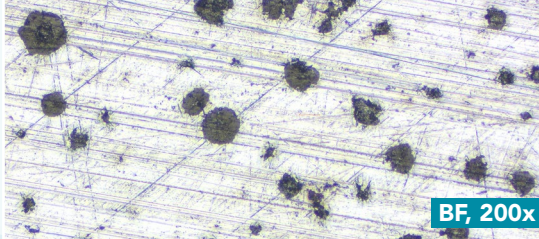





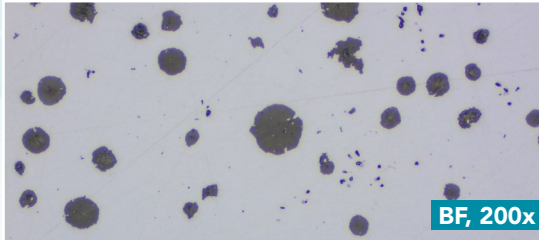





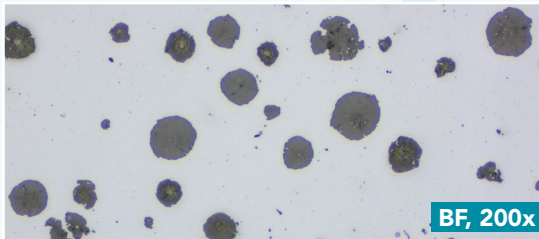


Aka-Brief #14 铸铁

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
| | Piatto 220 | 水 | 300 RPM | 30 N | 磨平 | | BF, 200x |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |
| | Allegran 3 | DiaUltra 9 μm | 150 RPM | 35 N | 3:30 min | | BF, 200x |
| 3 *** |  |  |  |  |  | |  |
| | Silk | DiaUltra 3 μm | 150 RPM | 30 N | 2:30 min | | BF, 200x |
| 4 * ** *** **** |  |  |  |  |  | |  |
| | Chemal** | Colloidal Silica 50 nm Alkaline | 150 RPM | 15 N | 1 min | | BF, 200x |

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

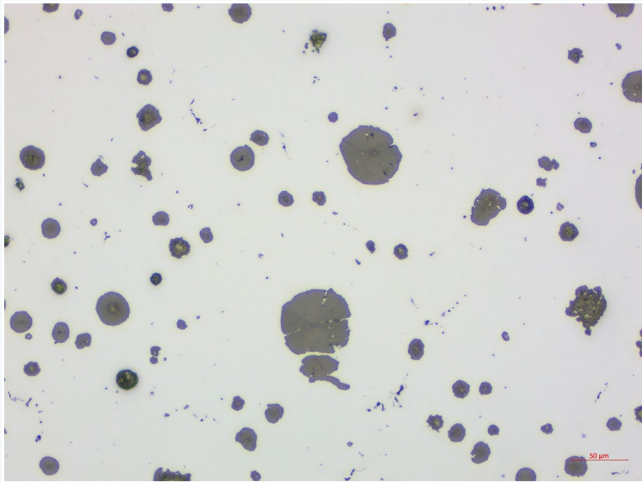
*第四步是可选的。

**开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

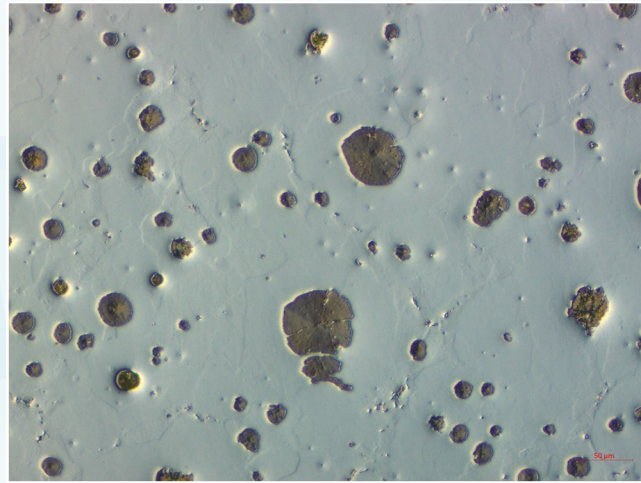
***氧化抛光后能得到无划痕的样品表面，但是在样品表面会出现一些凹凸不平现象。为了减弱这种凹凸不平现象，可以使用DiaUltra 1微米在Napal抛光布上进行终抛来代替这一步。

Aka-Brief #14 铸铁

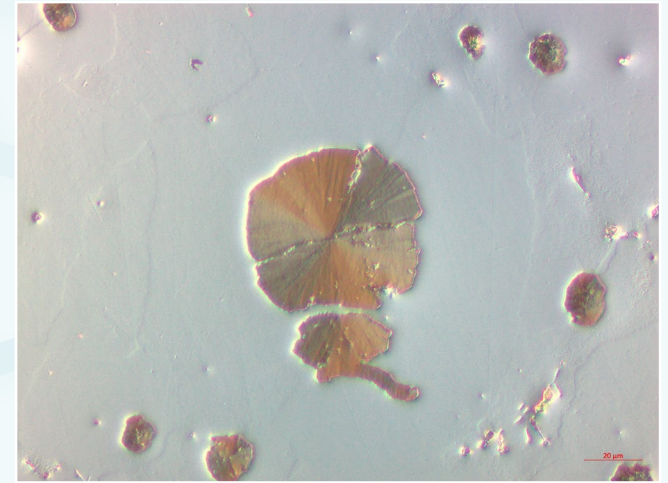
最终制样结果



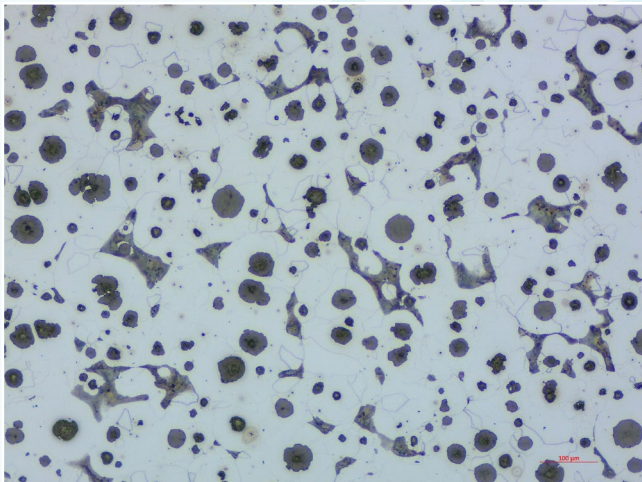
明场像，200倍



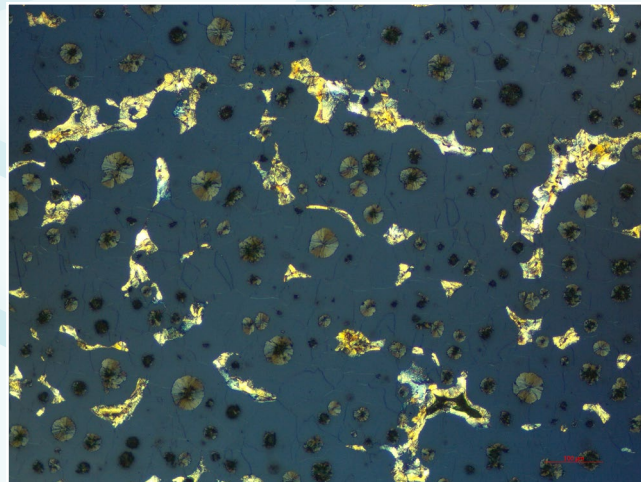
微分干涉衬度像，200倍



微分干涉衬度像，500倍



3%硝酸腐蚀，明场像，200倍



3%硝酸腐蚀，偏正光，200倍